



VIA presenta VIA ALTA DS 3 Edge AI System con processore Snapdragon™ 820 Embedded Platform

Una soluzione che accelera lo sviluppo e la diffusione di dispositivi Edge intelligenti per un utilizzo in ambito retail in grado di migliorare notevolmente l'approccio e l'impiego da parte dei clienti.

Milano, 25 settembre 2018 – VIA Technologies, Inc., presenta oggi il sistema **VIA ALTA DS 3 Edge AI**. Grazie al processore Qualcomm® Snapdragon 820E Embedded Platform, il sistema consente di sviluppare in modo rapido soluzioni digital signage, chioschi multimediali e dispositivi di controllo accessi che richiedono capacità di acquisizione, elaborazione e visualizzazione di immagini e video in tempo reale.

VIA ALTA DS 3 sfrutta le innovative capacità di elaborazione, grafica e intelligenza artificiale del Qualcomm® Snapdragon™ 820E Embedded Platform per facilitare lo sviluppo di soluzioni immersive in un sistema dal design compatto e a basso consumo energetico.

Oltre al supporto per il doppio display 4K, che include la funzione mirroring e la riproduzione video indipendenti, il sistema offre numerose opzioni di connettività grazie alla porta Gigabit Ethernet, oltre alla possibilità di scegliere integrazioni wireless Wi-Fi & Bluetooth 4.1 o 4G LTE. Il design resistente e di dimensioni ridotte include una fotocamera flessibile e una ricca sezione I/O grazie a tre porte USB 3.0, una porta Mini USB 2.0 e uno slot miniPCIe. Altre caratteristiche includono una RAM POP LPDDR4 da 4GB, una flash memory eMMC da 16GB, uno slot M.2, uno slot per schede SD e un jack audio line-in/out.

Per facilitare lo sviluppo di software e applicazioni AI, VIA ALTA DS 3 è dotato di un BSP con Android 8.0 che include il Qualcomm® Neural Processing SDK per intelligenza artificiale, progettato per aiutare gli sviluppatori a eseguire uno o più modelli di rete neurale su ambienti Caffe/Caffe 2, ONNX, o TensorFlow, che si tratti di CPU, GPU o DSP.

*“VIA ALTA DS 3 fornisce una piattaforma altamente integrata in grado di accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative in ambito retail”, ha commentato **Richard Brown, Vice-President of International Marketing, VIA Technologies, Inc.** “Grazie alla possibilità di personalizzare hardware e software, il sistema può essere ottimizzato per soddisfare appieno i requisiti di sviluppo edge AI, fornendo al contempo la scalabilità necessaria per futuri miglioramenti.”*

Disponibilità

Il VIA ALTA DS 3 è ora disponibile per spedizioni in tutto il mondo al prezzo di US\$399, escluse le spese di spedizione <https://www.viaembeddedstore.com/shop/systems/alta-ds-3/>

Per ulteriori informazioni:

<https://www.viatech.com/en/systems/android-signage-players/alta-ds-3/>

Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili qui:

<https://www.viagallery.com/alta-ds-3/>

A proposito di VIA Technologies, Inc.

VIA Technologies, Inc. è leader globale nello sviluppo di piattaforme embedded e soluzioni di sistema altamente integrate per applicazioni AI, IoT, visione artificiale, veicoli autonomi, sanità e smart city. Con sede centrale a Taipei, Taiwan, la rete globale di VIA collega i centri ad alta tecnologia negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. La sua base di clienti include molti marchi leader mondiali nel settore dell'alta tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'elettronica di consumo.

www.viatech.com

Alimentato dalla piattaforma embedded Qualcomm® Snapdragon™ 820, un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc., sussidiaria di Qualcomm Incorporated.

Qualcomm, Snapdragon, Kryo, Adreno e Hexagon sono marchi registrati di Qualcomm Incorporated, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Qualcomm Spectra è un marchio registrato di Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Kryo, Qualcomm Adreno, Qualcomm Hexagon e Qualcomm Spectra sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc.

I nomi delle società e dei prodotti citati nel presente documento potrebbero essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.